

Anmeldung



Direkt über unseren Online-Shop

www.bayern-innovativ-shop.de/leiterplatten2019

> Anmeldeschluss

Dienstag, 22. Januar 2019

> Teilnahmebeitrag

Inkl. Dokumentation, Imbiss und Getränke:

Wirtschaft | Forschungsorganisation € 390,-

Mitglied im Forum MedTech Pharma e.V. € 310,-

Hochschule | Behörde € 220,-

Student (gültiger Studentenausweis erforderlich) € 70,-

Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.

> Teilnahmebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung an Ihre E-Mail-Adresse. Die Rechnung wird separat an Ihre Postadresse versendet. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebeitrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebeitrag fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist nach Absprache möglich. Bayern Innovativ behält sich unvermeidliche Programmänderungen vor.

Fachausstellung

Informationen und Bewerbungsunterlagen:

www.bayern-innovativ.de/veranstaltung/leiterplatten2019#!ausstellung

Bewerbungsschluss: 8. Januar 2019



Veranstaltungshinweise



www.bayern-innovativ.de/veranstaltung/leiterplatten2019

> Tagungsort

Maritim Hotel
Frauentorgraben 11
90443 Nürnberg

> Tagungszeit

Dienstag, 29. Januar 2019
09:00 – 18:00 Uhr Fachausstellung
10:00 – 17:00 Uhr Fachvorträge

> Anfahrt

www.bayern-innovativ.de/leiterplatten2019/hinweise

Kostenpflichtige Parkplätze stehen in begrenzter Zahl in den umliegenden Parkhäusern zur Verfügung. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (3 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof) wird empfohlen.

> Konzeption und Organisation

Bayern Innovativ GmbH

Am Tullnaupark 8, 90402 Nürnberg

Konzeption: Jürgen Frickinger

T +49 911 20671-160

frickinger@bayern-innovativ.de

Organisation: Jessica Olbrysch

T +49 911 20671-142

anmeldung@bayern-innovativ.de

www.bayern-innovativ.de

Partner

FED



ZVEI:
Die Elektroindustrie

Medienpartner



bayern innovativ

die leiterplatte zwischen „all-in-one package“ und gedruckter schaltung.

15. Kooperationsforum mit Fachausstellung



Maritim Hotel
Nürnberg, 29. Januar 2019



Einladung

Wir freuen uns, Sie im Jahr 2019 bereits zum 15. Mal zu unserem Kooperationsforum Leiterplatten einladen zu können.

Mit regelmäßig über 200 Teilnehmern hat es sich über die Jahre als fester Termin im Kalender der Branche etabliert. Die heutige Leiterplatte hat mittlerweile eine enorme Bandbreite entwickelt, auf die wir am 29. Januar 2019 den Fokus legen werden.

Die adressierten Themenschwerpunkte reichen deshalb von electronic grain | elektronischem Staub – derzeit als „all in one package“ zunehmend in Smartphones zu sehen – bis zur konventionellen Leiterplatte mit all ihren Varianten. Praxisnahe Anwendungsbeispiele umfassen Applikationen von Automotive bis Industrie 4.0. Die begleitende Fachausstellung bildet einen idealen Treffpunkt für die Fortführung von Diskussionen und gezielte Kontaktaufnahmen.

Die Ausrichtung erfolgt gemeinsam mit dem ZVEI Bayern, dem VDMA Bayern, dem FED e. V. und erfährt die Unterstützung durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Wir freuen uns, Sie in Nürnberg zu begrüßen.

Jürgen Frickinger

Dr. Peter J. Thelen



Jürgen Frickinger
Teamleiter Technologie
Bayern Innovativ GmbH
Nürnberg



Dr. Peter J. Thelen
Geschäftsführer
ZVEI – Landesstelle Bayern
München



Programm

09:00 Registrierung und Besuch der Fachausstellung

Moderation: Jürgen Frickinger

Programm Komitee | Bayern Innovativ GmbH

Hans Joachim Friedrichkeit

Programm Komitee | PCB-NETWORK

10:00 Begrüßung und thematische Einführung

Jürgen Frickinger

Teamleiter Technologie
Bayern Innovativ GmbH, Nürnberg

10:15 Der Blick voraus | Technologietreiber für Leiterplatten von morgen

Hans Joachim Friedrichkeit

Inhaber, PCB-NETWORK,
Business Solutions, Maulburg/Südbaden

11:00 Warum die Auswahl von Laminaten wichtig ist

Roland Schönholz

Leiter technisches Marketing,
TECHNOLAM GmbH, Troisdorf

11:30 Batteriezellverbinder auf Basis FPC Technologie

Dr. Wolfgang Bochtler

CEO, Mektect Europe GmbH, Weinheim

12:00 Mittagspause in der Fachausstellung

13:15 Von der Leiterplatte zu „all in one package“

Johannes Stahr

Group Technology Manager,
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft, Leoben, Österreich

13:45 Embedding, auch im Prototypen- und mittleren Serien-Bereich

Holger Schmidt

Engineering, ILFA Industrieelektronik und
Leiterplattenfertigung aller Art GmbH, Hannover

14:15 Leiterplatten für GHz-Anwendungen – Simulation der Übertragungseigenschaften

Hermann Reischer

Vertrieb und Support,
Polar Instruments GmbH, Nussdorf

14:45 Kaffeepause in der Fachausstellung

15:30 „Semiconductor Embedding“ wird zur Schlüsseltechnologie für Leistungselektronik und Radarsensoren

Dirk Gennermann

Head of Product Marketing & KAM,
Schweizer Electronic AG, Schramberg

16:00 Die Extrameile als Erfolgsrezept: Anwendungsbeispiele von Automotive bis Industrie

Stefan Hörth

Produktmanager, KSG Austria GmbH,
Gars am Kamp, Österreich

16:30 SMD Embedding für den Mittelstand

Dr. Andreas Ostmann

Group Manager Embedding & Substrates,
Fraunhofer IZM, Berlin

17:00 Get-together in der Fachausstellung und Ausklang mit Buffet und Getränken